

2018



深科技非全日制硕士联合培养



使命、愿景、价值观

值得信赖
受人尊敬

使 命

提供优质的电子产品研发制造服务，为社会创造价值，为员工提供发展平台

愿 景

成为值得信赖并受人尊敬的企业

价 值观

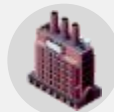
团队合作 以人为本
追求卓越 勇于创新
诚实守信 共同发展
稳健财务 服务社会



公司简介



全球领先的**EMS**企业, 为客户提供**研发、制造、供应链、物流、系统解决方案**等全产业链服务



成立于**1985**年, **1994**年在深交所挂牌上市 (**000021.SZ**)



总部位于深圳福田区, 共**9**个生产基地, 逾**30,000**员工



国家**高新技术企业**, 2016年销售收入**150**亿元人民币



位列世界**EMS**企业前列



CEC集团核心企业之一, 中国**500**强企业, 深圳工业百强企业**12**位



中国电子信息产业集团

成立：1989年5月

注册资本：86.3亿人民币

销售收入：1950亿人民币 (2017)

世界500强企业：第362位 (2017)

员工人数：140,000



PANDA 群达



TPV
VISION INNOVATOR



光谷联合
OPTICS VALLEY UNION



中国·振华



桑达股份



IRICO



彩虹集团新能源股份有限公司
Caihong Group New Energy Company Limited

中國電子集團控股有限公司

工厂布局

- SMT线体：160条
- 厂房面积：455,900 m²



美国NPI中心：2017年

- 厂房面积：1,000 m²
- 员工人数：待定



成都工厂：2016年

- 厂房面积：10,000 m²
- 员工人数：1,000



苏州工厂：2005年

- 厂房面积：70,000 m²
- 员工人数：1,600



惠州工厂：2013年

- 厂房面积：120,000 m²
- 员工人数：8,000



马来西亚工厂：2014年

- 厂房面积：9,500 m²
- 员工人数：800



东莞工厂：2015年

- 厂房面积：170,000 m²
- 员工人数：13,000



泰国工厂：2014年

- 厂房面积：2,000 m²
- 员工人数：100



菲律宾工厂：2017年

- 厂房面积：4,400 m²
- 员工人数：300



深圳工厂：1985年

- 厂房面积：50,000 m²(福田)+20,000 m²(石岩)
- 员工人数：3,000(福田) + 1,000(石岩)



全球布局



发展历程

1985-1995

磁头业务稳步发展

- 1985 - 深科技在深圳**蛇口**工业区成立，开始生产计算机**硬盘磁头**
- 1992 - 被认定为深圳市**高新技术企业**，迁至**福田彩田园区**
- 1994 - 在深交所正式挂牌**上市**

1996-2006

业务多元化发展

- 1996 - 导入**硬盘盘基盘**业务
- 1997 - 开始生产硬盘**薄膜磁头**
- 1998 - 意大利智能电表研发项目启动
- 2000 - 开启中国对意大利**第一个技术出口（智能电表）项目**
- 2003 - 正式启动与**Epson**合作项目
- 2003 - 成立**开发微电子MEC**，与**Kingston**开启固态存储模组产品生产制造合作
- 2005 - 与**Seagate**启动全面合作

2007-2017

业务多元化发展

- 2007 - 与**Samsung**签署合作协议生产手机
- 2009 - 与**ZTE**开启通讯业务合作生产手机与**Resmed**开始医疗产品生产制造业合作
- 2010 - **LED MOCVD**项目落户厦门
- 2012 - 与**Huawei**开启终端产品制造合作，生产智能手机及可穿戴产品
- 2015 - 收购**Payton**，导入半导体封装及测试业务，完成封测-模组整体制造链
- 2015 - 开始电子产品**维修服务**
- 2016 - 与**vivo**开启智能手机制造合作
- 2017 - 与**FPC**开启指纹识别封装的合作
- 2017 - 进入**无人机**生产制造领域

主要业务

计算机 & 储存

- 硬盘 PCBA
- 硬盘 HSA
- 硬盘 FPC
- 硬盘 基盘



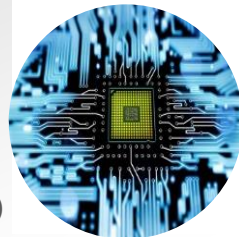
通讯电子 & 消费

- 智能手机
- 智能可穿戴
- 维修服务



半导体

- 记忆/指纹IC
- DRAM 模组
- 闪速储存器 (CF/SD/USB/SSD)



医疗器械

- 呼吸机
- MRI控制器
- 智能汤勺
- 智能血糖仪



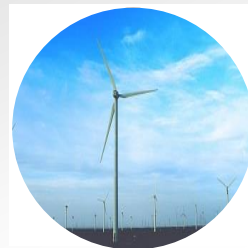
汽车电子

- 无人机
- ABS 控制
- 导航系统
- 智能传感器



商业与工业

- 投影仪
- 新能源产品
- 小批量多品种产品



自动化

- 自动化设备
- 自动化解决方案



计量系统

- 智能电表
- 智能水表
- 智能气表
- 能源管理系统

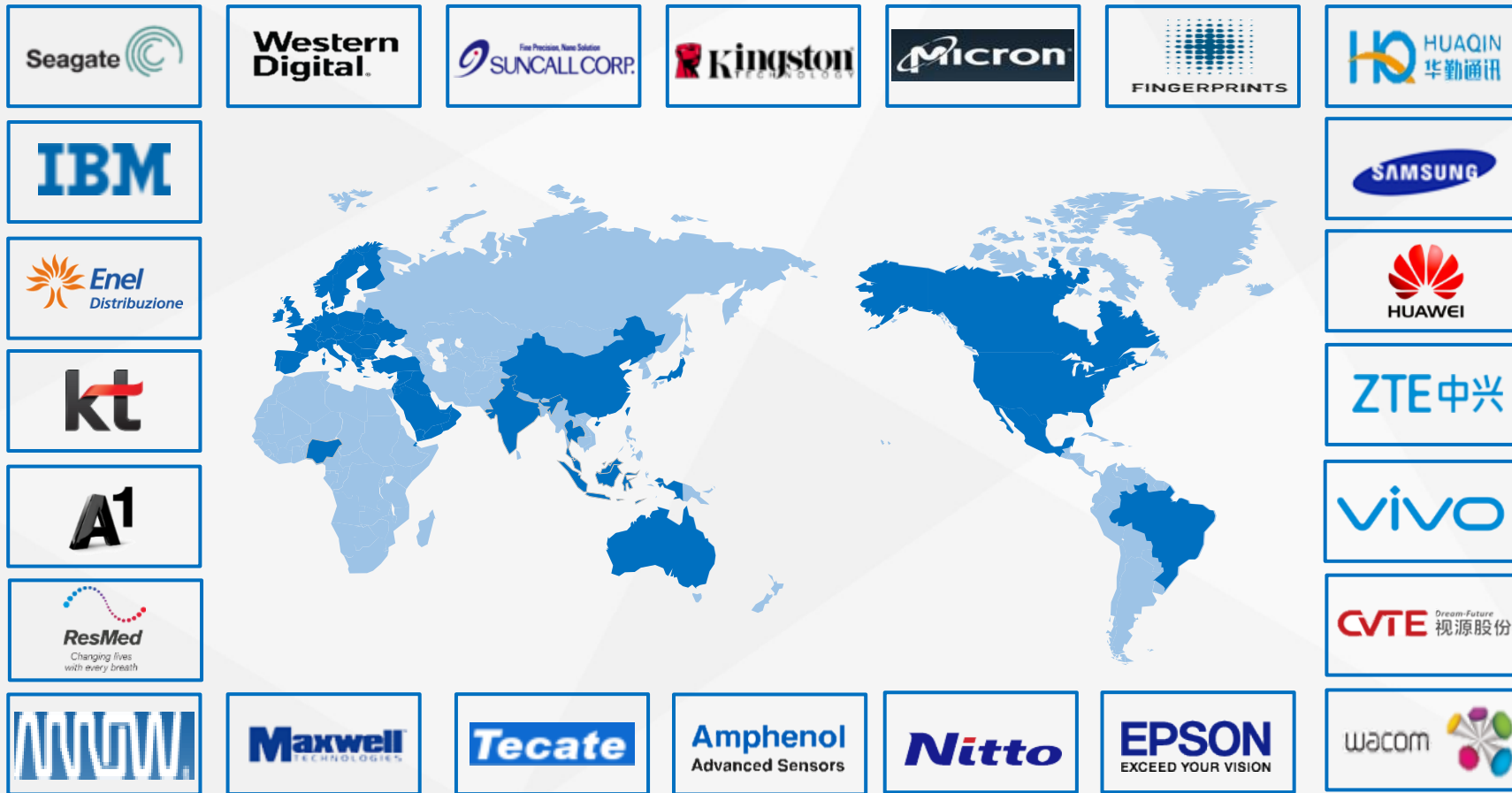


工业物联网

- iDAS
- 静电监控系统
- IOT系统
- 实时定位系统



客户分布



管理体系



企业资源管理
系统



制造执行系统



六西格玛



产品生命周期
管理



平衡记分卡



企业业务流程
再造



卓越绩效管理



企业知识产权
管理

非全日制硕士联合培养招生政策

LAB联合培养专业需求

专业	研究方向	数量需求
微电子/物理（应用物理、半导体物理、凝聚态物理）/电子信息工程、电磁兼容	<ul style="list-style-type: none">● 微电子器件（失效分析、ESD）● 半导体/集成电路失效分析（失效分析、ESD）● 微电子制造（失效分析）● 电子制造（失效分析、可靠性）● 电磁兼容（可靠性）● 微电子可靠性（可靠性）● 失效物理（失效分析、ESD）	3

培养政策

第一年：签培养协议，在校学习，提供助学金；

第二年：签实习协议，在公司实习，储干培训、岗位培训、实习津贴、免费住宿、餐补等；

第三年：签劳动合同，在公司上班，工资及五险一金，住房补贴、餐补、享受法定员工假期等；

第四年：比企后签劳动合同三年，最低服务两年，否则按违约处理；毕业后按同期硕士储干标准执行。



成为值得信赖并受人尊敬的企业

Web: www.kaifa.cn Tel: +86-755-83032000 Email: contact@kaifa.cn



深科技000021



深科技



Shenzhen Kaifa Technology Co.,Ltd

